

Boydについて

Boydは、お客様の重要なアプリケーションをシールド、保護、接続、冷却するための材料科学、産業用素材、熱管理テクノロジーで世界をリードする革新的な企業です。

Boydは、各種テクノロジーを今までにない方法で組み合わせ、新たな可能性を実現することにより、技術革新を提案します。



~100年
技術革新をリード



\$1.33億
全世界での売上



40+
全世界に工場を展開



8500+
全世界での従業員数



~300
特許保持数



670+
技術者数



Boydのソリューションは、5Gインフラ／世界最高水準のデータセンターのハイパフォーマンス化、電気自動車／自律走行車の信頼性の向上と連続走行距離の延長、最先端の健康管理システム／診断システムの精度の向上、高信頼性が要求される航空機技術／軍事技術の実現、次世代エレクトロニクス／HMIの迅速なイノベーションに貢献しています。



Boydのグローバルな製品量産体制は、廃棄物を減らしカーボンフットプリントを最小化する、サステナブルで無駄のないオペレーションによる環境保護への深いコミットメントに裏付けられています。

Boyd Technologies Japan 合同会社

沿革

- 1940年代 テキサス・インスツルメンツ
異種金属圧延技術（クラッド技術）を応用した電子部品向け接続用接触子の開発
- 1970年代 インレイクラッド技術を用いたカードエッジコネクタがIBM AT/XT とクローンPCの内部バスコネクタとして全面採用となる
- 1984年 半導体出荷を支える
バーンインテストソケットの開発
- 1986年 業界初オープントップソケットの開発
- 1993年 業界初BGA用オープントップソケットの開発
- 2002年 NASAのガスタイト技術を用いた高信頼性ソケットの開発
- 2006年 テキサス・インスツルメンツ金属事業部が独立し、センサータ・テクノロジーズ社になる
スクラッチフリーのLGA向けオープントップBITSの開発
- 2022年 ゴールドマン・サックスグループBOYD社のサーマルテストアンドコントロールズ事業部となる

社名	Boyd Technologies Japan 合同会社
設立	2022年5月
資本金	3億1円
代表社員 職務執行者	エイ・ビー・ボイド・カンパニー エリック・ストリック
事業内容	半導体バーンイン・テスト用ソケットの開発・製造・販売
本社	神奈川県横浜市港北区新横浜 2丁目6番地3 DSM新横浜ビル9F